

股票简称:有方科技

股票代码:688159

neoway 有方 深圳市有方科技股份有限公司

SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO., LTD.

(深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房 2 号 4 层)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD.

贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

二〇二〇年一月

特别提示

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”、“公司”或“发行人”)股票将于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司郑重提示广大投资者注意,凡上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如与本特别提示中说明,本公司公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

本公司公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司郑重提示广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%,首日跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业在上市后的前 5 个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二) 流通股数量

上市初期,原始股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投的股份锁定期为 24 个月,高管及核心员工专项资管计划战略配售股份锁定期为 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后本公司无限售流通股为 1,866,0655 万股,占发行后总股本的 20.35%。本公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率处于较高水平

本次发行价格为 20.3 元/股,此价格对应的市盈率为:

1.3699 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益归母净利润计算);本次发行前总股本计算);

2.3217 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益归母净利润计算);本次发行前总股本计算);

3.4931 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益归母净利润计算);本次发行前总股本计算);

4.4290 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会准则审计的扣除非经常性损益归母净利润计算);本次发行前总股本计算);

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至 2020 年 1 月 3 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.82 倍,本次发行价格对应的公司 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 49.31 倍,高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全额担保比率为 130%—200%;流动性风险是指,股票在股价波动幅度较大时,融资融券客户可能无法继续持有股票而被强制平仓,从而产生较大的损失。

(五) “Modem 模式”和“SOC 模式”的特点对比如下表:

| 类别 | Modem 模式 | | SOC 模式 | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | 优点 | 缺点 | 优点 | 缺点 |
| 性能优缺点 | 不集成限制,需外用处理器等元器件才能实现; | 其方面的性能组合优势; | 高集成度使产品缺乏灵活性。 | 功耗大。 |
| 成本 | 需配置多种芯片,原材料成本较高。 | 减小了芯片配置数量,降低原材料成本。 | 设计难度与研发投入大,开发周期长,主要是因为 1.硬件配置规模庞大,通常基于 IP 设计模式;2.软件体积大,需要进行软硬件协同设计;3.仿真与验证过程复杂且耗时。 | 成本高。 |
| 研发投入和周期 | 研发投入和周期较长 SOC 方案较大幅度减少和缩短。 | | | |
| 产品认证 | Modem 模块作为单独的部件会通过全项测试,因此采用应用处理器+Modem 模块方式的终端设备,由于产品的多样性和平台的复杂度,每款产品必须独立通过各类级别的认证测试,大大增加产品的研发时间和周期。 | | | |
| 市场应用和占有率 | 在物联网领域,绝大部分带无线通信功能的设备主要应用于智能手机和平板电脑等消费电子产品,其他应用领域尚未使用或普及。 | 主要应用在智能手机和平板电脑等消费电子产品,其他应用领域尚未使用或普及。 | | |
| 终端设备 | 终端设备的功能定位和应用场景需求,对于应用处理器需求较高,倾向使用“Modem 模式”,以便于方案的灵活设计和配置,这部分在物联网终端占比比较大;而对应用处理器相对统一,与 SOC 平台本身的特异性高度符合、无线通信功能作为标准件的需求量较小。 | 终端设备的功能定位和应用场景需求,对于应用处理器需求较高,倾向使用“Modem 模式”,以便于方案的灵活设计和配置,这部分在物联网终端占比比较大;而对应用处理器相对统一,与 SOC 平台本身的特异性高度符合、无线通信功能作为标准件的需求量较小。 | 终端设备 | 终端设备 |

2. 规模效应:对于物联网中某些智能终端设备,需求较为分散,市场份额呈现碎片化,“Modem 模式”仍是主流方案;而对于智能手机等消费电子设备,需求较为统一,市场规模大,拥有更低成本的“SOC 模式”更受青睐。

3. 芯片供应商在不同领域的地位:在智能手机等无线通信产品领域,基带芯片供应商地位优势明显,因此“SOC 模式”得以大力推广;而在其他应用领域未出现该情况。

综上,公司所选取的“Modem 模式”是目前大部分物联网终端设备采用的主流方案,而集成功能的应用处理器方案目前主要应用于智能手机和平板电脑等消费电子领域,其他的硬件方案则具有应用处理器多样化的功能,灵活性较低,市场竞争速度较快等弱点,后者的硬件方案具有应用处理器多样化的功能,灵活性较低,研发投入和周期长,但对公司的经营业绩影响不大。

3. 评估方法:不会对产品形成大规模替代。此外,公司已在 2017 年实现应用无线通信技术的终端产品销售,并在最近一年及一期保持了终端产品销售收入的快速增长,亦有效降低了上述风险。

4. 技术进步带来的收入/产品技术迭代的风险

5G 技术对公司长期持续增长的风险

物联网行业发展趋势,蜂窝通信技术(3G/4G/5G)的快速迭代为物联网行业不断带来新的应用场景和业务机会,5G 是目前蜂窝通信技术最前沿的演进技术,未来 5G 的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。国际标准化组织 3GPP 定义了 5G 三大应用场景,包括:eMBB,适用于 3D/超高清视频等大流量移动宽带业务;mMTC,适用于大规模物联网业务;uRLLC,适用于无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的服务。

虽然公司已进行了较多 5G 相关关键技术及芯片平台的前期研究论证并将其作为本次主要募投项目实施,但如果公司在 5G 技术运用中未成功地进行技术及产品研发并及时满足市场需求和客户需求,将对公司的募集资金投资项目和生产经营造成不利影响。

6. 委外加工方式生产的风险

公司的产品采用委外加工方式生产,委外加工生产模式有利于公司有有限的资源集中于研发、销售等核心价值,以能够适应行业技术和产品更新迭代的特点,快速地推出适合市场需求的产品,公司在选择委外加工时十分重视对方的资质信誉和生产能力,并且建立了一整套质量控制生产运营、质量管理体系以保证对外加工产品质量。但由于公司采购的产品均通过委外加工生产,可能存在因外协加工产品质量问题、交货期等问题,导致公司产品品质降低、交货延误的风险,从而对公司的经营带来不利影响。

7. 主要原材料采购价格波动的风险

芯片是公司产品的重要原材料,报告期内,公司芯片采购支出占采购总额的比例分别为 74.61%、69.48% 和 64.13%。报告期内,公司芯片类原材料最终来源主要为境外,比如高通、三星等,公司主要原材料芯片存在依赖进口的风险,具体来源国家(地区)及金额如下表:

国家(地区) 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年

美国 55.82% 64.75% 72.91% 66.07%

韩国 24.73% 16.61% 6.69% 17.71%

中国台湾 5.89% 10.03% 10.81% 11.05%

中国大陆 10.56% 4.08% 4.71% 8.67%

日本 2.66% 4.42% 4.73% 6.40%

其他 0.36% 0.11% 0.14% 0.11%

公司芯片类原材料来源中,美国占比最高,但自 2018 年有所下降。目前公司的基

带芯片采购主要集中于高通与联发科,在物联网行业中,上述芯片生产厂商掌握核心技术,而国内芯片供应商的大规模投入替代率和应用验证进度,且在短时间内市场中可替代的芯片供应商较少;加之近年来部分发达国家经济增速放缓,国际贸易保护主义抬头之势,若未来因国际贸易摩擦导致芯片供应不足,海外原材料供应商销售策略和销售价格发生较大幅度的波动,将对公司的产品供应及产品成本产生不利影响。

本公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

1. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

2. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

3. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

4. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

5. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

6. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

7. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

8. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

9. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元件的选型,目前,随着国内大力发展成像电路、产业链的深入,朝伟、展锐等公司研发实力的提升,报告期末公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计的小批量应用的可能。

10. 智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用高通 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列表”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的“应用+智能电网领域”的产品。

<p